

Zaproszenie do składania ofert na licencję/nabycie praw do rozwiązania Politechniki Poznańskiej pt.:

Warstwowy laminat do produkcji desek i paneli podłogowych oraz drewnopodobnych pokryć podłogowych lub ściennych

Rodzaj rozwiązania

Wynalazek

Idea rozwiązania

Przedmiotem wynalazku jest warstwowy laminat zawierający połączone ze sobą warstwy litego drewna oraz kompozytową, w którym warstwa kompozytowa zbudowana jest z materiału kompozytowego o osnowie z polimeru termoplastycznego, napełnionego materiałem lignocelulozowym opartym na włóknach naturalnych, paździerzach lub słomie rzepakowej. Przedmiotem zgłoszenia jest także sposób łączenia warstwy litego naturalnego drewna z warstwą materiału kompozytowego o osnowie z polimeru termoplastycznego.

Zalety rozwiązania i przewaga rynkowa

- laminaty wg wynalazku w szczególności mogą zostać wykorzystane do produkcji desek podłogowych, paneli oraz drewnopodobnych pokryć podłogowych lub ściennych,
- rozwiązanie wg wynalazku proponuje zastąpienie obecnie stosowanego w warstwach środkowej i dolnej deficytowego drewna iglastego przez materiał kompozytowy otrzymany z pochodzących z recyklingu materiałowego odpadowych materiałów lignocelulozowych (np. słoma rzepakowa, paździerz lniane i konopne, trociny) oraz polimerów termoplastycznych (np. polipropylen, polietylen lub polichlorek winylu),
- materiały kompozytowe w porównaniu z naturalnym drewnem cechują się lepszymi właściwościami fizykochemicznymi, takimi jak: dźwiękochłonność, stabilność wymiarowa, udarność, palność i przewodnictwo ciepłe korzystne dla zastosowań przy ogrzewaniu podłogowym, a także większą odpornością na działanie czynników zewnętrznych, takich jak np. wilgoć i grzyby,
- laminat wg wynalazku jest pierwszym rozwiązaniem, który umożliwia wytworzenie desek z drewnem naturalnym, które mogłyby być stosowane przy ogrzewaniu podłogowym,
- rozwiązanie pozwala na uzyskanie oszczędności materiałów drzewnych poprzez rezygnację ze stosowania dolnej trzeciej warstwy na korzyść konstrukcji dwuwarstwowej z papierem przeciwpiętnym,
- łączenie warstw wg rozwiązania przebiega w temperaturze nieznacznie podwyższonej, tj. ok. 40-80°C i jest efektem przebiegu reakcji sieciowania oraz umożliwia klejenie warstwy kompozytowej z drewnem liściastym jak i iglastym,
- kompozyty polimerów termoplastycznych napełnione materiałem lignocelulozowym nadają się do recyklingu materiałowego oraz do odzysku energii.

Potencjalni klienci

Branża drzewna, obejmująca zakłady produkujące podłogi dwu- i trzywarstwowe, wykończenie wnętrz, przetwórstwo drewna i materiałów drewnopodobnych oraz branża budowlana.

Poziom gotowości technologicznej (TRL)

TRL 4 - potwierdzenie technologii w skali laboratoryjnej.

Stan ochrony prawnej

Przyznany patent

Warstwowy laminat oraz sposób jego wytwarzania nr Pat.237679.

<https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.423199>

Preferowana forma komercjalizacji

Licencja niewyłączna.

Forma przekazania praw

Dokumentacja patentowa, dokumentacja techniczna, wyniki badań, prototyp.

Informacje dodatkowe

1. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.
2. Politechnika Poznańska (PP) odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do wartości rozwiązania.
3. PP w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na cenę.
4. PP wezwie oferentów do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, jeżeli nie będzie możliwe dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na otrzymanie ofert z taką samą ceną.
5. PP zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli złożone oferty będą zawierały ceny, których wartość nie będzie przewyższała wartości rozwiązania.
6. PP zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.
7. PP ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od prowadzonego postępowania bez wyboru oferty.
8. Zawarcie umowy jest uwarunkowane spełnieniem procedur przewidzianych przepisami prawa obowiązującymi uczelnie.

Sposób składania ofert

Oferty powinny być składane w języku polskim, w formie pisemnej na adres Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej lub elektronicznej na adres e-mail jednostki.

Dane kontaktowe

Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
Biuro 409
60-965 Poznań
ctt@put.poznan.pl

Opracowano dnia 18.03.2021 r.